

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

无锡帝科电子材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-008

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称	中金公司、清河泉资本、正心谷资本等 5 位投资者
时间	2023 年 9 月 19 日
地点	上海分公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：彭民先生 应用技术部&市场部副总经理：南亚雄先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、简要介绍</p> <p>受益于全球光伏市场的强劲需求以及 N 型电池的快速产业化，因为 N 型电池光伏导电银浆单耗与单位加工费都高于 P 型电池，光伏导电银浆行业迎来了量利齐升的快速发展期。公司作为国内光伏导电银浆行业龙头企业，一方面顺应行业发展机遇，另一方面依托技术创新与产品领先优势，在 N 型 TOPCon 电池导电银浆市场份额处于行业领先地位，上半年公司营业收入与净利润双双实现快速增长。2023 年上半年，公司实现营业收入 347,531.77 万元，同比增长 108.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 20,272.58 万元，同比增长 630.47%。</p> <p>2023 年上半年，公司光伏导电银浆实现销售 642.88 吨，较上年同期增长 117.89%；其中应用于 N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品实现销售 261.83 吨，占公司光伏导电银浆产品总销售量比例快速提升至 40.73%，处于行业领导地位。随着光伏行业 N 型电池尤其是 TOPCon 电池产能快速放量，公司将</p>

持续加大产品技术研发与市场开拓力度，进一步巩固公司在光伏电池导电银浆行业的领先地位。

二、问答环节

1、公司下半年出货情况以及出货结构展望？

答：2023 年上半年，公司光伏导电银浆实现销售 642.88 吨，其中应用于 N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品实现销售 261.83 吨。受益于 TOPCon 快速产业化，公司业务依然处于快速发展期，从上半年经营情况来看，公司全年 TOPCon 银浆产品销量占比预期在 50%左右。

2、了解公司加工费变化情况？

答：公司的 PERC 银浆和 TOPCon 银浆的加工费在上半年相对稳定，相较于 PERC 银浆，TOPCon 银浆的加工费要高 40%-50%，HJT 银浆加工费会比 PERC 和 TOPCon 更高。

3、公司国产银粉的导入占比情况是怎样的？

答：公司 PERC 电池银浆已经做到 80%以上的国产粉占比；TOPCon 电池正、背面银浆综合起来看，年底国产粉导入有望达到 50%左右占比；HJT 产品目前还是以进口银粉为主。

4、如何应对汇兑损益风险？

答：公司主要原材料银粉进口采购金额仍较大，近一年多，美元兑人民币汇率高企，对于进口企业来说比较难。公司本期采用的付款策略是汇率阶段性低点时直接用人民币购汇，汇率高时采用美元贷款，待之后汇率下降时择机锁汇或购汇。未来公司将继续密切关注国内外政治、经济形势等，择机开展外汇衍生产品交易业务，进行合理的外汇风险管理；同时，公司也将继续推进国产银粉替代，降低进口银粉采购比例，以减少汇率波动对公司产生的影响。

5、公司异质结银浆和银包铜浆料的进展情况？

答：异质结方面，公司在低温纯银浆料路线和银包铜路线是持续双线推进发力，已在多家行业头部企业完成了产品认

证，产品性能指标处于行业领先水平。低温纯银浆料长期处于稳定供货交付阶段，低温银包铜浆料在行业龙头客户处已经实现稳定批量生产，下半年开始逐步放量。

6、公司在 BC 电池领域的优势？

答：公司从 2020 年开始就已经实现了 BC 电池浆料的规模化供应，是国内首家提供 BC 电池浆料的金属化解决方案提供商。公司持续与下游客户合作开发迭代不同类型 BC 电池的浆料产品，是多家龙头客户 BC 电池的浆料供应商。

7、公司在 TOPCon 正面银铝浆与同行相比有哪些技术优势？

答：TOPCon 正面是硼扩散极，需要使用全新类别的银铝浆产品以实现良好的电性能，特别是行业从常规工艺往 SE 工艺升级切换后，对于玻璃粉与铝粉等无机组合开发、细线印刷提出了更高的要求。公司银铝浆产品的转换效率处于行业领先地位，具有非常宽的工艺窗口，可以良好匹配不同类型的 SE 工艺需求，同时公司银铝浆产品在超细线印刷方面也处于行业领先地位。未来，公司一方面会进一步强化工艺窗口与超细线印刷能力的优势，同时会进一步加快产品迭代升级，给客户不断带来更高的转化效率。

8、在 TOPCon 银浆领域公司的优势是什么？

答：首先，TOPCon 电池作为新一代电池技术需要浆料企业具有前瞻性的布局，而公司在 2017 年左右与行业内的一些领先客户在 TOPCon 前代技术 N-PERT 上就开始了相关合作和量产，2019 年左右开始和 TOPCon 领先企业合作开发全套金属化浆料方案，技术储备很早；其次，TOPCon 电池不管正面还是背面的浆料，核心体系是玻璃粉的开发设计，公司是全行业少有的，自主设计玻璃粉体系又自主制造的银浆公司，在 TOPCon 市场启动由国内企业主导的情况下，公司能够贴近客户需求进行快速响应，并对产品进行动态优化调整；再次，公

	<p>公司在 PERC 时期积累了大量的优质的客户资源和客户结构，在公司具备了有竞争力的产品后，为公司导入优质客户、快速获取市场份额奠定了基础。未来，公司将加强研发投入，加强销售团队和技术团队的建设，持续投入 TOPCon 的迭代技术开发，保持公司未来长期处于领先的市场地位。</p> <p>9、公司布局金属粉、硝酸银在战略上是如何考虑的？</p> <p>答：光伏行业持续快速增长将有效支撑导电银浆市场的长期增长，基于供应链的安全和稳定性，公司向上游布局硝酸银。公司金属粉的布局主要是面向异质结低温浆料和半导体封装浆料所用的银包铜粉、纳米银粉进行的储备和规划。</p> <p>10、公司半导体浆料未来的进展和后续放量的节奏？</p> <p>答：公司布局的非光伏业务主要聚焦在半导体电子领域，主要分为三个方向的产品：一是 LED 与 IC 芯片封装粘接银浆在不同导热系数场景的应用；二是面向第三代功率半导体芯片封装粘接的烧结银产品，在超高散热场景的应用，是未来功率半导体发展的关键材料之一；三是功率半导体封装用 AMB 陶瓷覆铜板钎焊浆料。与光伏银浆相比，半导体封装浆料品类较多，导入验证的节奏和时间较长。公司将围绕这三大方向持续进行产品完善和迭代，客户群体现处于从小规模的验证客户向中等体量的客户切换过渡阶段，未来公司将重点培育、持续推进，不断拓宽公司产品的应用领域和市场。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 9 月 19 日